



Esponja em formato de wafer

Esponja de polimento extremamente fina e macia para remoção de hologramas em pinturas escuras. Ø 150 mm

N.º pedido: 6 37 23 029 01 0

Adaptável para as seguintes máquinas

- > Kit WPO 10-25 E
- > WPO 14-25 E
- > Kit WPO 14-15 E
- > WPO 14-15 E